

杭州士兰微电子股份有限公司

关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案)(修订稿)》修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年6月30日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2021年第14次并购重组委工作会议，对杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得有条件通过，审核意见为：“请申请人补充披露标的资产的经营风险、未来盈利能力以及本次交易作价的公允性。请独立财务顾问核查并发表明确意见。”

根据并购重组委审核意见，公司对《杭州士兰微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）等文件进行了相应补充和更新，相关内容在重组报告书中以楷体加粗的形式列示。现就本次修订情况说明如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：

序号	重组报告书（修订稿）章节	修订内容
1	重大风险提示	在“二、标的资产的经营风险”补充披露行业周期性波动风险、资本开支和研发支出持续增加的风险、芯片制造行业竞争风险、生产设备采购风险等经营风险。
2	第六章 标的公司评估情况	在“三、士兰集昕评估情况”之“（九）上市公司董事会对本次交易标的评估合理性以及定价公允性的分析”之“6、交易定价的公允性”中补充披露本次交易作价的公允性相关内容。
3	第九章 管理层讨论与分析	在“五、标的公司盈利能力分析”之“（二）士兰集昕”之“2、利润的主要来源及盈利能力的持续性和稳定性分析”之“（3）盈利能力的持续性和稳定性分析”中补充披露标的公司未来的盈利能力相关内容。
4	第十二章 本次交易的报批事	在“三、标的资产的经营风险”补充披露行业周

	项及风险提示	期性波动风险、资本开支和研发支出持续增加的风险、芯片制造行业竞争风险、生产设备采购风险等经营风险。
--	--------	---------------------------------------------------

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2021年7月6日